

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-073

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于公司所属行业变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）近年来重点聚焦半导体创新材料领域，持续拓展半导体新材料产品布局，着力打造进口替代类创新材料的平台型公司。

公司自 2012 年开始向半导体材料业务领域转型。经过十余年的深耕布局，依托材料领域较强的研发、产业化、体系及客户服务能力，公司在半导体创新材料领域构建了丰富的产品矩阵，实现了 CMP 抛光垫、CMP 抛光液、清洗液，新型柔性显示用 YPI（黄色聚酰亚胺）、PSPI（光敏聚酰亚胺）、TFE-INK（薄膜封装材料）等进口替代类电子专用材料及集成电路芯片的产业化和规模销售，并完成半导体先进封装材料（半导体封装 PI、临时键合胶）、高端 KrF/ArF 光刻胶、半导体显示材料新品（PI 取向液、无氟光敏聚酰亚胺（PFAS Free PSPI）、黑色光敏聚酰亚胺（BPD L）、薄膜封装低介电材料（Low Dk INK））的业务布局。

目前，半导体材料及芯片业务已成为公司重要业绩来源。2023 年度，公司光电半导体材料及芯片业务：其营业收入占公司总营业收入的比例为 32.12%，其毛利润占公司总毛利润的比例为 53.44%。同时，该业务板块的上述比重占比，在 2024 年前三个季度持续同比、环比提升中。按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》的相关规定，经公司申请，并由上市公司行业分类专家委员会确认，公司行业类别由原行业分类“C26 化学原料和化学制品制造业”，变更调整为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业——C398 电子元件及电子专用材料制造”。

截至本公告披露日，公司已正式启用新行业分类。上述行业类别调整，标志着公司已成功实现战略转型，并将迎来新的发展阶段。公司半导体新材料业务将成为驱动公司主营业务收入及利润双增长的重要动力。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2024年10月11日